

4971 **メック**

前田 和夫 (マエダ カズオ)

メック株式会社社長

## 決算期を12月に統一、事業運営の効率化をはかる

### ◆2017年12月期業績概要

日本単体と海外子会社の決算期がずれていたため、第49期から12月決算に統一した。そのため当期の連結対象期間は、変則的に日本単体が9カ月、海外子会社が12カ月となる。

2017年12月期は、為替が想定レートより円安に進捗した。薬品は、前年同期比で(2017年3月期を当期12月期の経過期間と同期間に組み替えた数値比較)売上高が21.3%増、出荷量が17.3%増となった。為替の影響は、売上高2億14百万円増、営業利益1億48百万円増となっている。

2017年12月期の連結業績(変則決算)は、前期比で売上高18.2%増、営業利益18.3%増、経常利益21.6%増、当期純利益3.5%増、薬品売上高21.3%増となった。海外売上高比率は若干下がり、主力のCZシリーズの売上高は47億87百万円で順調に推移、対薬品売上高は50.5%となり依存率が若干減じた。これは、他の製品の売り上げが増加したためである。粗利率はほぼ横ばいで推移した。当社薬品海外使用分の国内代理店販売を海外売上高に加算した場合の比率は前期77.7%、当期74.9%となっている。

### ◆2017年12月期決算詳細

常務執行役員管理本部長 北村 伸二

連結損益計算書について、前連結会計年度との比較は非常に難しいため、2017年11月2日発表の修正計画と比較した。当期売上高は96億41百万円(計画比4億41百万円増)となった。内訳は、薬品売上94億80百万円、機械売上56百万円、資材売上94百万円である。営業利益は19億93百万円(同93百万円増)、経常利益は20億63百万円(同1億13百万円増)、親会社に帰属する当期純利益は15億67百万円(同1億67百万円増)となった。

連結貸借対照表を見ると、流動資産では、受取手形および売掛金が日本の売上が8億26百万円増加したことにより36億11百万円となった。その他は、尼崎事業所建設に伴う消費税額と売上にかかる消費税の差額が還付されたため2億74百万円減少し78百万円となった。固定資産では、有形固定資産の建設仮勘定が主に欧州の新社屋完成により73百万円減少し27百万円となった。その結果、資産合計は12億54百万円増加し192億47百万円となった。流動負債の1年内返済予定の長期借入金、および固定負債の長期借入金については、尼崎事業所建設資金の借入総額20億円のうち7億50百万円を返済し、残額12億50百万円となった。設備関係未払金は、尼崎事業所設備関係が1億69百万円減少したことにより36百万円となった。株主資本の利益剰余金は、11億81百万円増加し134億33百万円となった。その結果、純資産合計は14億77百万円増加し145億87百万円となり、自己資本比率は75.8%となった。

連結キャッシュフロー計算書について、現金および現金同等物期首残高37億23百万円に対し、同期末残高は36億64百万円となり、58百万円減少している。

四半期推移については、第3四半期で比較すると、売上高は堅調に増加している。営業利益は、数量増加に伴

い利益率がかなり改善されている。経常利益は、為替が前期マイナス、当期プラスだったためかなり変動している。当期純利益は、台湾の租税協定による税率変更に伴い税率が大幅減となり、若干減少している。

品種別四半期推移を見ると、当期第3四半期は四半期ベースで初めて28億円を超えている。薬品別では、銅表面処理剤が大幅に伸び、剥離剤も1億円弱の増加となった。密着向上剤(CZ、V-Bond、FlatBOND、UT等)、エッチング剤(EXE、SF等)はともにおおむね伸長した。薬品別出荷数量についてもともに伸びている。

CZシリーズの売上高推移を見ると、主力のCZ-8101が大幅に伸び、CZ-8100も自動車関係で堅調に伸びている。

地域セグメント別売上高推移と海外比率を見ると、日本の大幅増に伴いアジアも伸び、欧州は安定的に推移した。

### ◆2018年12月期通期連結業績予想

第49期の日本単体分を12カ月で組み替えた数値と比較すると、2018年12月期(第50期)の通期連結業績は、売上高116億円(前期比7.9%増)、営業利益23億円(同1.7%減)、経常利益24億円(同0.1%増)、当期純利益17億50百万円(同3.0%減)の計画である。

販管費については減価償却費や人件費、売上増に伴う発送運賃費が増加し、営業利益が若干減となっている。当期純利益に関しては、前期は日台租税協定により法人税等が低税率だったため利益率が1.7%程度高かったことから、今期若干減の見通しとなっている。

### ◆今後の事業展開

社長 前田 和夫

当社の製品は、半導体周りやディスプレイ等さまざまなものに使われる消耗薬品である。5GやIoT、人工知能搭載ハードウェアを含め各種センサー、メモリー、プロセッサ等すべてに関係しており、中長期的には非常に良いポジションに位置していると言える。

当社のコア技術は、配線を形成する技術(EXE)、表面を粗化し物理的に密着性を向上させる技術(CZ、UT、V-Bond)、選択エッチング技術(SF、CH)、表面を処理し化学的に密着性を向上する技術(FlatBOND)の4つである。

当社が成長するためのキーワードは5G、IoT、AI、自動運転である。非常に重要な5Gは、高速大容量が求められ、FlatBONDやCZ、UT等が使われる可能性がある。IoTやAIでは多くのセンサーが使われ、またエッジコンピューティングも増加するため、CZや主力の薬品が恩恵にあずかる。自動運転については、基本的な薬品として信頼性を上げるためにCZやV-Bondが用いられている。

CZシリーズは、銅の結晶粒部よりも結晶粒界部が早くエッチングされるため、独特の凹凸形状が形成される。処理は銅の結晶粒に頼っているため、特殊電解銅の表面は粗化できるが圧延銅はできない。圧延銅はフレキシブル基板関係で多く使われており、圧延銅の粗化剤としては新開発のUTシリーズの採用が進んでいる。

FlatBONDは、高周波帯で必要とされるものである。電気信号はスピードが上がるほど銅の表面を走るため、高周波帯で真っ平らな状態で電気を通す必要があり、5Gの基地局試作品やスパコン用マザーボードに採用されている。

CHシリーズはNi-Crシード層を除去する選択エッチング技術で、最近増加している。

アマルファは、化学エッチングにより金属と樹脂を直接接合させる技術で携帯端末の金属筐体の製造工程で使用されている。

現在、電子基板製造関連分野は技術の変化が起こっており、当社のコア技術を拡張しながら深掘りを進めていく。ディスプレイ関連分野も同様で、その他樹脂金属接合関連分野においては接合に限らず化学関係にも広くコア

技術を求め、事業領域の拡大を目指していく。

当社の経営戦略の根幹は、技術マーケティングの強化、オープンイノベーションの推進、ESG-H 戦略の推進である。世の中の変化に即応したアイデアが出せる人材を求めて育て、事業戦略に直結させていく。

## ◆ 質 疑 応 答 ◆

**当期業績について、特徴的な点について解説してほしい。**

全体的によかったが、自動車向けとスマホやディスプレイ関連分野が好調だった。

**今期業績が前期ほど伸びない見通しであるのはなぜか。**

スマホの先行きが読みにくく、スマホ、タブレット向けの売上げが全体の 5 割近くを占めているため、全体的に前期に比べ抑えめにみている。

**今期増収も利益が伸びない理由は。**

販管費として、人件費、売上げ増に伴う発送運賃、減価償却等が増加するとみている。

**設備投資した当時の狙いと現状を教えてください。**

関西の 3 拠点を統合する目的で、尼崎事業所を作った。研究開発と生産、営業が分かれており、意思疎通が悪くなったことと、1980 年代に建てた工場の老朽化と場所の狭さ、近隣の土地の接収もできない状況があった。研究所も同様で、思い切って投資した結果、開発スピードと精度が上がり、変化に即応できる環境となった。

(2018 年 2 月 16 日・東京)

\* 当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。

<http://www.mec-co.com/ir/library/>